

9-215570-0 ✓ AKTIV

Micro-MaTch | Micro-MaTch Industrial

Interne TE-Nummer 9-215570-0

PCB Mount Paddleboard Connector, Vertical, Cable-to-Board, 20 Position, .05 in [1.27 mm] Centerline, Ribbon Cable, Micro-MaTch Industrial

[Auf TE.com ansehen>](#)



[Steckverbinder](#) > [PCB-Steckverbinder](#) > [Board-In-Steckverbinder](#) > [Paddle Board-Steckverbinder](#)



PCB-Steckverbindermontagetyp: **Paddleboard-Steckverbinder zu Leiterplattenmontage**

Montageausrichtung für Leiterplatte: **Vertikal**

Steckverbindersystem: **Kabel-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: **20**

Raster: **1.27 mm [.05 in]**

[Alle Paddle Board-Steckverbinder \(20\)](#)

Eigenschaften

Produktmerkmale

PCB-Steckverbindermontagetyp	Paddleboard-Steckverbinder zu Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem	Kabel-an-Leiterplatte
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte, Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

Drahteingangsposition	Oben
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Anzahl von Positionen	20
Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp	Flachbandkabel
Zeilenanzahl	2

Elektrische Kennwerte

Isolierwiderstand	1000 MΩ
Arbeitsspannung	100 VAC

Sonstige Eigenschaften

Primäre Produktfarbe	Rot
----------------------	-----

Kontaktmerkmale

Dicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	3 – 5 μm[118.11 – 196.85 μin]
---	-------------------------------

Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs des Drahts	1 µm[39.37 µin]
Beschichtungsfläche des Drahtanschlussbereichs	Matt
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts	Zinn
Oberfläche des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Matt
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts	Nickel
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
Kontakt-nennstrom (max.)	1.5 A

Klemmenmerkmale

Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke	.5 mm[.02 in]
Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite	.4 mm[.015 in]
Anschlussstift- und Restlänge	3.2 mm[.125 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anslusstechnik

Art der Leiterplattenmontage	Geknickte Lötendstücke
Montageausrichtung der Leiterplatte	Mit
Arretierung für Leiterplattenmontage	Mit

Gehäusemerkmale

Raster	1.27 mm[.05 in]
Gehäusematerial	PBT GF

Abmessungen

Steckverbinderlänge	28.9 mm[1.138 in]
Steckverbinderhöhe	5.1 mm[.2 in]
Reihenabstand	2 mm[.059 in]
Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich	.8 – 1 mm[.035 – .039 in]
Drahtgröße	.08 – .09 mm ²

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
---------------------------	----------------------------

Betrieb/Anwendung

Lötverfahrenfunktion	Plattenabstand
Stromkreis Anwendung	Signal

Industriestandards

Zugelassene Standards	UL E28476
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	250
Verpackungs-Typ	Karton, Kasten

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2023 (235) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2023 (235) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Wellenlötfähig bis 265 °C

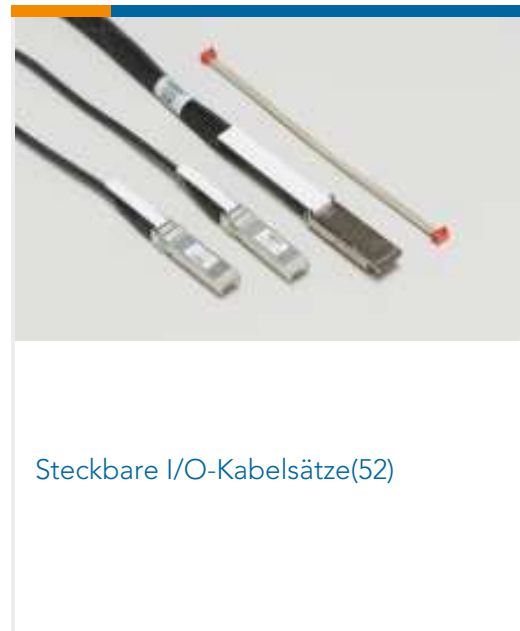
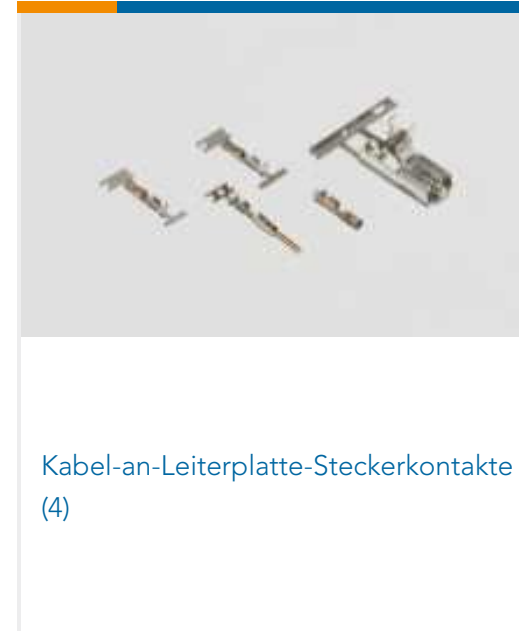
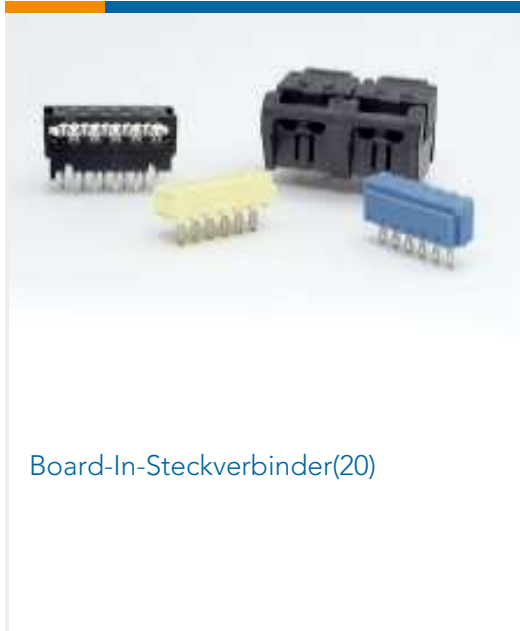
Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | Micro-MaTch Industrial



Kunden kauften auch diese Produkte



Dokumente

Produktzeichnungen

MICRO-MATCH PBC.20P

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_9-215570-0_S.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_9-215570-0_S.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_9-215570-0_S.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

Micro-MaTch Catalog

Englisch

Ribbon Cable Interconnect Solutions

Englisch

Centerline Micro-Match Connector Series

Englisch

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch

micro match miniature connector system

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

Product Compliance Document

Englisch

Product Compliance Document

Englisch